

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號： 1347

新聞稿

華虹半導體二零一四年第四季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國上海 — 2015年2月3日 — 全球領先的200mm純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零一四年十二月三十一日止三個月的綜合經營業績。

二零一四年第四季度摘要

- 二零一四年第四季度銷售額為 1.661 億美元，同比增加 15.1%。
- 二零一四年第四季度毛利率為 29.1%，高於去年同期的 24.8%。
- 二零一四年第四季度淨利潤為 1,920 萬美元，同比增加 1.1%。

二零一五年第一季度指引

- 銷售收入預期與上季度持平，較去年同期將有所上升。
- 毛利率預期與上季度持平。
- 由於市場需求旺、產能利用率高，預計第一季度將優於往年同期。

華虹半導體總裁兼執行董事王煜先生表示：“二零一四年第四季度，我們的訂單需求持續強勁、產能利用率也因此保持在 93.3% 的高位。

我們第四季度業績主要亮點有：

- 來自 0.13 μ m 及以下技術節點的產品銷售收入占到了銷售收入總額的 40.7%。
- 按技術平臺劃分，來自嵌入式非易失性存儲器產品和分立器產品的銷售收入分別占到了銷售收入總額的 42.5% 與 19.3%。
- 從銷售區域來看，中國仍是我們最大的市場，其貢獻的銷售收入約佔我們銷售收入總額的 52.6%。

進入 2015 年，我們繼續看好全球半導體市場、尤其是中國市場。我們正在全速實施產能擴充計劃，決心竭盡全力來滿足客戶的需求。”

網上/電話會議公告

日期：二零一五年二月四日

時間：上海時間上午十時

網上會議：二零一四年第四季度業績說明網上直播可于以下網址收聽：

http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 或

<https://engage.vevent.com/rt/huahongsemiconductor~q42014earningscall>

電話直撥：	國際	+61 283 733 610
	中國	+86 800 870 0210
		+86 400 120 3170
	香港	+852 3051 2792
	臺灣	+886 2 7743 8419
	美國	+1 845 507 1610
	新加坡	+65 3158 0667

會議 ID 76205018

密碼 HUAHONG

該網絡直播會議的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都將在本新聞稿發佈後 6 個月內刊登於華虹半導體的網站上。

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司(「本公司」，香港聯交所代號: 1347)是一家全球領先的 200mm 純晶圓代工廠。本公司在上海設有三家晶圓廠，主要專注製造特種應用的 200mm 晶圓半導體。本公司生產的半導體被廣泛應用於不同市場各類產品，包括電子消費品、通訊、計算機、工業及汽車等。本公司採用自身的專有工藝及技術，為多元化的客戶製造符合其設計規格的半導體，本公司亦提供設計支援服務，以便及時完成在工藝的性能、成本及製造成品率各方面均達致完善的複雜設計。

詳細資訊請參考華虹半導體網站 <http://www.huahonggrace.com/>

二零一四年第四季度經營業績概要
以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第四季度 (未經審核)	同比
銷售收入	166,129	174,002	(4.5)%	144,373	15.1%
銷售成本	(117,730)	(117,966)	(0.2)%	(108,517)	8.5%
毛利	48,399	56,036	(13.6)%	35,856	35.0%
毛利率	29.1%	32.2%		24.8%	
經營開支	(26,045)	(23,308)	11.7%	(23,361)	11.5%
其他收入，淨額	3,038	4,861	(37.5)%	11,531	(73.7)%
稅前溢利	25,392	37,589	(32.4)%	24,026	5.7%
所得稅開支	(6,240)	(8,476)	(26.4)%	(5,078)	22.9%
期內溢利	19,152	29,113	(34.2)%	18,948	1.1%
以下各方應佔利潤：					
母公司擁有人	19,152	29,113	(34.2)%	18,948	1.1%
非控制權益	-	-	-	-	-
持有人應佔每股盈利					
基本	0.02	0.04	(50.0)%	0.02	0.0%
攤薄	0.02	0.04	(50.0)%	0.02	0.0%
付運晶圓(仟片/約當 8 吋)	343	372	(7.8)%	291	17.9%
產能利用率 ¹	93.3%	96.1%	(2.8)%	80.7%	12.6%

- 二零一四年第四季度銷售額為 1.661 億美元，同比增加 15.1%，較上季度的 1.740 億美元減少 4.5%。
- 二零一四年第四季度銷售成本為 1.177 億美元，較上季度的 1.180 億美元略降 0.2%。
- 二零一四年第四季度的毛利率為 29.1%，低於上季度的 32.2%，主要由於：(i) 安排在第四季度的歲修（1 號晶圓廠和 2 號晶圓廠）導致產能利用率略有下降 (ii) 產能擴充造成的折舊及攤銷費用增加，以及 (iii) 年終獎金。
- 二零一四年第四季度經營開支由上季度的 2,330 萬美元增加至 2,600 萬美元，主要是由於年終獎金。
- 二零一四年第四季度的期內溢利為 1,920 萬美元，同比增加 1.1%。

¹ 產能利用率按平均月產量除以總估計月產能計算。

銷售收入分析

按類別劃分的銷售收入	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一三年 第四季度 (未經審核)
晶圓	95.7%	96.4%	97.3%
其他	4.3%	3.6%	2.7%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 我們 95.0%以上的銷售收入仍主要來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按區域劃分的銷售收入	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一三年 第四季度 (未經審核)
中國 ²	52.6%	52.7%	53.5%
美國	19.1%	23.0%	17.8%
亞洲 ³	10.3%	9.9%	7.7%
歐洲	9.5%	9.3%	10.3%
日本 ⁴	8.5%	5.1%	10.7%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 在二零一四年第四季度期間，中國仍是我們最大的市場，其貢獻的銷售收入佔我們銷售收入總額的 52.6%。同時，我們的第二大市場（美國）貢獻的銷售收入從上季度的 23.0%下降到 19.1%，主要由於一家美國客戶訂單的下降。日本市場銷售收入的增長主要來自於一家日本客戶需求的強勁增長。

銷售收入分析

按技術平臺劃分的銷售收入	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一三年 第四季度 (未經審核)
嵌入式非易失性存儲器	42.5%	43.5%	39.0%
分立器	19.3%	20.4%	17.2%
模擬與電源管理	14.7%	15.8%	11.4%
邏輯及射頻	12.5%	11.5%	21.6%
獨立非易失性存儲器	9.4%	8.0%	9.7%
其他	1.6%	0.8%	1.1%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 在二零一四年第四季度期間，來自嵌入式非易失性存儲器產品和分立器產品的銷售收入分別占銷售收入總額的 42.5%與 19.3%。

² 包括香港。

³ 不包括中國及日本。

⁴ 包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一名主要日本客戶。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一三年 第四季度 (未經審核)
0.13 μ m 及以下	40.7%	39.4%	38.5%
0.15 μ m 及 0.18 μ m	18.5%	18.7%	24.2%
0.25 μ m	0.6%	1.0%	1.1%
0.35 μ m 及以上	40.2%	40.9%	36.2%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 我們一直策略性地專注於更先進的技術節點，如 0.13 μ m、0.11 μ m 及 90nm。因此，來源於 0.13 μ m 及以下技術節點的產品銷售收入佔比在二零一四年第四季度增長到 40.7%，上季度和去年同期的銷售佔比分別為 39.4%和 38.5%。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一三年 第四季度 (未經審核)
電子消費品	53.9%	48.7%	46.5%
通訊	23.9%	29.8%	32.4%
工業及汽車	12.4%	10.3%	8.8%
計算機	9.8%	11.2%	12.3%
銷售收入總額	100.0%	100.0%	100.0%

- 電子消費品及通訊分別為我們最大及第二大的終端市場分佈，這兩類市場在二零一四年第四季度貢獻的銷售收入占我們總銷售收入的 75%以上。

產能⁵及產能利用率

晶圓廠 (仟片晶圓每月)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	二零一三年 第四季度 (未經審核)
1 號晶圓廠	50	50	50
2 號晶圓廠	39	39	34
3 號晶圓廠	40	40	40
總估計月產能	129	129	124
產能利用率	93.3%	96.1%	80.7%

- 我們二零一四年第四季度的月產能為 12.9 萬片 200mm 等值晶圓。產能利用率與去年同期相比從 80.7% 提高到 93.3%。由於季節性原因以及安排在第四季度的歲修（1 號晶圓廠和 2 號晶圓廠），產能利用率與上季度相比略有下降。

⁵ 在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且為了比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

8 吋等值晶圓 (仟片晶圓)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第四季度 (未經審核)	同比
付運晶圓	343	372	(7.8)%	291	17.9%

- 由於季節性因素及工廠歲修（1 號晶圓廠和 2 號晶圓廠），二零一四年第四季度的付運晶圓環比下降 7.8%，但同比增加了 17.9%。

經營開支分析

以千美元計	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第四季度 (未經審核)	同比
銷售及分銷費用	2,085	1,558	33.8%	2,257	(7.6)%
管理費用 ⁶	23,960	21,750	10.2%	21,104	13.5%
經營開支	26,045	23,308	11.7%	23,361	11.5%

- 二零一四年第四季度的經營開支從上季度的 2,330 萬美元上升至 2,600 萬美元，主要由於年終獎金。

其他收入淨額分析

以千美元計	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)	環比	二零一三年 第四季度 (未經審核)	同比
租金收入	3,695	3,251	13.7%	3,274	12.9%
利息收入	1,247	1,299	(4.0)%	3,283	(62.0)%
財務費用	(2,638)	(2,958)	(10.8)%	(4,171)	(36.8)%
分佔一家聯營公司溢利	17	1,591	(98.9)%	5,805	(99.7)%
其他	717	1,678	(57.3)%	3,340	(78.5)%
其他收入淨額	3,038	4,861	(37.5)%	11,531	(73.7)%

- 二零一四年第四季度其他收入淨額從上季度的 490 萬美元下降至 300 萬美元，主要由於聯營公司出售房地產溢利的減少。

⁶管理費用包括確認為研發開支的政府補助的抵消項目。

流動性概述 (以千美元計)

	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)	於九月三十日 二零一四年 (未經審核)
存貨	93,988	84,924
貿易應收款項及應收票據	107,509	113,867
預付款項、按金及其他應收款項	7,254	5,235
應收關聯方款項	41,402	51,561
已抵押存款及定期存款	2,583	12,586
現金及現金等價物	646,773	342,399
流動資產總額	899,509	610,572
貿易應付款項	65,258	62,571
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	70,357	69,375
計息銀行及其他借款	81,690	100,982
政府補助	64,367	51,938
應付關聯方款項	24,883	16,566
應付所得稅	23,311	18,326
流動負債總額	329,866	319,758
淨營運資金	569,643	290,814
速動比率	2.4x	1.6x
流動比率	2.7x	1.9x

- 現金及現金等價物從上季度末的 3.424 億美元增加至 6.468 億美元，主要由於：(i) 收到首次公開募股的資本金，(ii) 經營性現金淨流入，部份被 (i) 償還銀行借款及 (ii) 購買固定資產所抵消。
- 二零一四年第四季度末的存貨由上季度末的 8,490 萬美元增至 9,400 萬美元，主要是為了滿足客戶下几个季度的需求而備貨。
- 二零一四年第四季度末的應收關聯方款項由上季度末的 5,160 萬美元減少至 4,140 萬美元，主要由於回籠了一家關聯方的應收賬款。
- 二零一四年第四季度末的已抵押存款及定期存款由上季度末的 1,260 萬美元減少至 260 萬美元，主要由於一筆定期存款在二零一四年底到期。
- 二零一四年第四季度末流動負債總額增至 3.299 億美元，較上季度末的 3.198 億美元有所增加，主要由於：(i) 新收到的政府補助；(ii) 收到一家關聯方的預付租金。上述流動負債的增加被償還銀行借款部份抵消。
- 二零一四年第四季度末的淨營運資金為 5.696 億美金，流動比率為 2.7，上季度末則為 1.9。

資本結構 (以千美元計)	於十二月三十一日	於九月三十日
	二零一四年 (未經審核)	二零一四年 (未經審核)
現金及現金等價物	646,773	342,399
已抵押存款及定期存款	2,583	12,586
短期計息銀行借款	81,690	100,982
長期計息銀行借款	183,031	244,780
銀行借款總額	264,721	345,762
權益	1,465,336	1,120,214
資本負債比率 ⁷	(26.2%)	(0.8%)

現金流量概要(以千美元計)	二零一四年 第四季度 (未經審核)	二零一四年 第三季度 (未經審核)
	經營活動所得現金流量淨額	89,987
投資活動所用現金流量淨額	(21,448)	(18,884)
融資活動所得(用)現金流量淨額	235,834	(2,903)
外匯匯率變動影響淨額	1	1,106
現金及現金等價物增加淨額	304,374	44,263

- 二零一四年第四季度經營活動所得現金流量淨額為 9,000 萬美元，投資活動所用現金流量淨額為 2,140 萬美元，主要用於採購機器設備。本季度融資活動所得現金流量金額為 2.358 億美元，主要是由於收到首次公開募股的資本金，部份被償還銀行借款的支出所抵消。

資本開支概要

- 二零一四年第四季度資本開支為 2,140 萬美元，較上季度的 1,890 萬美元增加 13.2%，主要由於我們加快了產能擴充的進程。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com

⁷ (銀行借款及其他借款總額 - 現金及現金等價物以及已抵押存款及定期存款) / 總權益

華虹半導體有限公司
綜合損益表
(以千美元計, 除每股盈利和股數外)

	截至以下日期止三個月	
	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)	於九月三十日 二零一四年 (未經審核)
銷售收入	166,129	174,002
銷售成本	(117,730)	(117,966)
毛利	48,399	56,036
其他收入及收益	7,681	6,266
投資物業的公平值收益	1	-
銷售及分銷費用	(2,085)	(1,558)
管理費用	(23,960)	(21,750)
其他費用	(2,023)	(38)
財務費用	(2,638)	(2,958)
分佔一家聯營公司溢利	17	1,591
稅前溢利	25,392	37,589
所得稅開支	(6,240)	(8,476)
期內溢利	19,152	29,113
以下各方應佔利潤:		
母公司擁有人	19,152	29,113
非控股權益	-	-
持有人應佔每股盈利		
基本	0.02	0.04
攤薄	0.02	0.04
用於計算每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	995,756,000	805,176,000
用於計算每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	995,756,000	805,176,000

華虹半導體有限公司
綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至	
	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)	於九月三十日 二零一四年 (未經審核)
資產		
非流動資產		
物業、廠房及設備	569,136	569,881
投資物業	190,821	189,782
預付土地租賃款項	24,194	24,241
無形資產	15,330	13,645
於聯營公司的投資	43,281	43,045
可供出售投資	230,512	229,254
長期預付款項	8,237	5,852
遞延稅項資產	9,182	8,391
非流動資產總額	1,090,693	1,084,091
流動資產		
存貨	93,988	84,924
貿易應收款項及應收票據	107,509	113,867
預付款項、按金及其他應收款項	7,254	5,235
應收關聯方款項	41,402	51,561
已抵押存款及定期存款	2,583	12,586
現金及現金等價物	646,773	342,399
流動資產總額	899,509	610,572
流動負債		
貿易應付款項	65,258	62,571
其他應付款項、預收賬款及暫估費用	70,357	69,375
計息銀行及其他借款	81,690	100,982
政府補助	64,367	51,938
應付關聯方款項	24,883	16,566
應付所得稅	23,311	18,326
流動負債總額	329,866	319,758
流動資產淨額	569,643	290,814
總資產減流動負債	1,660,336	1,374,905
非流動負債		
計息銀行及其他借款	183,031	244,780
遞延稅項負債	11,969	9,911
非流動負債總額	195,000	254,691
淨資產	1,465,336	1,120,214
權益和負債權益		
股本	1,550,164	1,229,996
儲備	(84,828)	(109,782)
權益總額	1,465,336	1,120,214

華虹半導體有限公司
綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月	
	於十二月三十一日 二零一四年 (未經審核)	於九月三十日 二零一四年 (未經審核)
經營活動所得現金流量		
期內溢利	19,152	29,113
折舊及攤銷	21,616	17,641
應佔聯營公司溢利	(17)	(1,591)
營運資金的變動及其它	49,236	19,781
經營活動所得現金流量淨額	89,987	64,944
投資活動所得現金流量:		
購買物業、廠房及設備項目	(21,448)	(18,884)
投資活動所用現金流量淨額	(21,448)	(18,884)
融資活動所得現金流量:		
公開發行股份收到款項	320,150	-
償還銀行貸款	(81,711)	-
已付利息	(2,605)	(2,903)
融資活動所得(用)現金流量淨額	235,834	(2,903)
現金及現金等價物增加淨額	304,373	43,157
外匯匯率變動影響淨額	1	1,106
期初現金及現金等價物	342,399	298,136
期末現金及現金等價物	646,773	342,399

於本公告日期，本公司董事分別為:

執行董事

傅文彪(董事長)
王煜(總裁)

非執行董事

陳劍波
馬玉川
森田隆之
葉峻

獨立非執行董事

張祖同
王桂壩太平紳士
葉龍蜚

承董事會命
華虹半導體有限公司
傅文彪
董事長兼執行董事

中國，上海
2015年2月3日